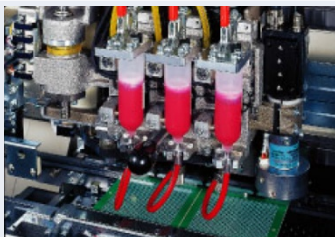
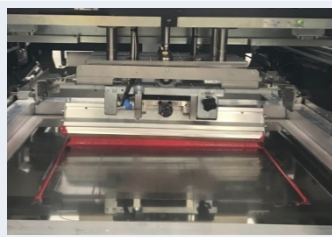


SMDフロー実装用低温硬化接着剤

低温・短時間硬化で部材への熱ダメージを低減

- 0603, 1005サイズ微小チップ部品の接着剤塗布を印刷工法で実現
- 印刷工法ではタクトが塗布点数に依存せず、スループット大幅向上
- 印刷・ディスペンス工法にそれぞれ適した低温硬化接着剤をラインアップ

工法		ディスペンス	印刷
設備			
対応部品サイズ		≧ 1608	≧ 0603
タクト	500点	△ 60 sec (0.12 sec x 500 dots)	◎ 12 sec (塗布点数に依存しない)
推奨SMD接着剤		MR-8128N	ADE510D

※印刷タクト：クリーニング不要、当社条件により

硬化温度と時間の比較

